

令和6年度 京都先端技術研究会・定例技術会議(現地講習会)

ものづくりのための分析技術講座シリーズ第3回

## 品質管理・研究開発に向けた試料前処理

～切断・研磨・観察～

主催 京都先端技術研究会、(地独)京都市産業技術研究所、

共催 京都市産業技術研究所ユーザーズコミュニティ (産技研UC)

ものづくりを行う上で、品質管理、研究開発の重要性が高まっており、その対象となる分野は金属、セラミックス、樹脂などの材料の評価、鋳造や焼結による製造の評価、めっき、窒化、浸炭、樹脂コーティングなどの各種表面処理の評価、工程改善など多岐にわたります。これらの材料・プロセス評価には、硬さ試験、断面観察、膜厚測定、組織観察、X線元素分析などがありますが、より良いデータを得るためには適切な前処理を行うことが必要です。日頃の技術相談では「これから各種評価を自社で行いたいので前処理方法を教えてほしい。」、「すでに実施しているが、基礎的な内容を勉強したい。」、「その都度、前処理方法を模索検討しているが、もっといい方法がないのか」、などの声をお聴きします。

本セミナーは令和4年度に実施しましたが、受講者の皆様だけでなく、多くの方々からも再開催を望む声をいただきました。この度、株式会社三啓様のご協力を得て、ものづくりのための分析技術講座シリーズ第3回『品質管理・研究開発に向けた試料前処理 ～切断・研磨・観察～』を下記のとおり開催いたします。本講座では、講義に加え、実際の研磨および観察の実演も行う予定です。本講座を通じて、前処理の流れについて体系的に触れていただき、皆様の技術力の向上に繋がることを期待しています。初心者から経験者まで幅広く対象としており、皆さまのご参加をお待ちしております。

### 記

日 時：令和7年2月20日(木) 13時00分～16時30分

会 場：株式会社三啓 大阪営業所 (〒564-0053 大阪府吹田市江の木町20-27)

集合場所：株式会社三啓 大阪営業所

アクセス：御堂筋線 江坂駅(南改札口)より徒歩15分 ※当日は車でのご参加はご遠慮ください。

開場時間：12時30分(受付を行います。)

開始時間：13時00分

内 容：「切断・研磨・観察」の前処理に関する講義と「研磨および観察」の実演

講義：13時00分～14時45分(金属材料と樹脂材料の研磨に関する基礎的な内容)

株式会社三啓 試料作製サポート部 ラボサポート課 関一紀 氏

実演：15時00分～16時30分(自動研磨機、手動研磨、樹脂包埋、フルオート倒立顕微鏡および実体顕微鏡観察等)

実演①：自動研磨機および手動研磨について(フルオート倒立顕微鏡にて観察)

株式会社三啓 試料作製サポート部 ラボサポート課 関一紀 氏

(裏面につづく)

実演②：樹脂包埋および真空含浸装置について（実体顕微鏡にて観察）

株式会社三啓 試料作製サポート部 部長 平野正人 氏

※2 班に分けて、実演①と実演②を交互に実施いたします。（各実演 45 分ずつ）

### 質疑応答およびアンケートご記入：16時30分～17時00分

対 象：品質管理・研究開発に向けた試料前処理に興味・関心をお持ちの方、経験者の方  
定 員：20 名※定員超過の場合のみお断りの連絡をします。

申込方法：京都市産業技術研究所の参加申込フォームから申し込みください。

参加申込フォーム：<https://tc-kyoto.or.jp/page-18775/>から申し込みください。

※申込確認メールが届かない場合はご連絡ください。

参 加 費：2,000 円 ※当日、会場受付にてお支払いください。

（ただし、京都先端技術研究会会員は無料、産技研 UC 会員は 1,000 円）



参加申込フォーム

締 切 日：令和 7 年 2 月 1 3 日（木）

問合せ先：地方独立行政法人 京都市産業技術研究所内

京都先端技術研究会 担当：丸岡、山梨、南

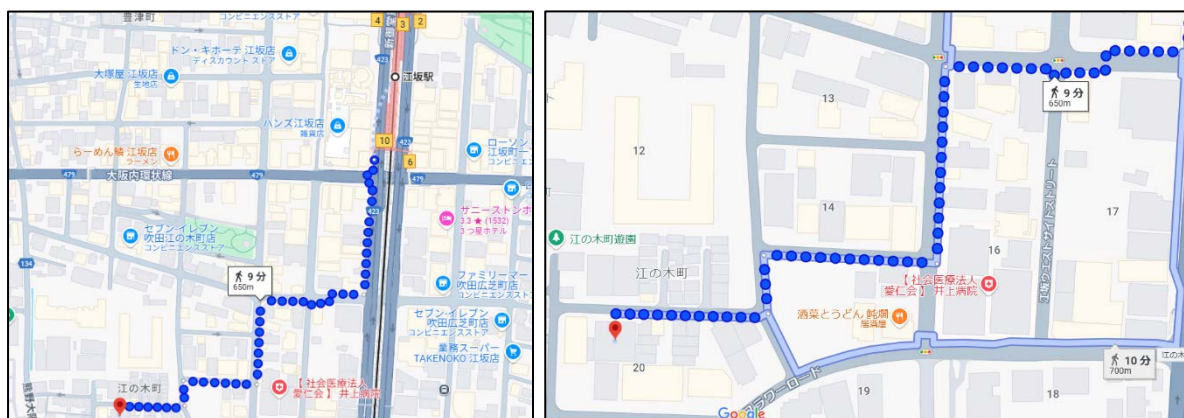
〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町 91

TEL：075-326-6100(代表)、E-mail：[kyoto-sentan\\_1985 \(ato\) tc-kyoto.or.jp](mailto:kyoto-sentan_1985@tc-kyoto.or.jp)、

※メールをお送りいただく際は、(ato) を@に変えてください。

<京都市産業技術研究所ホームページ：<https://tc-kyoto.or.jp>>

会場までのアクセス：



※当日は車でのご参加はご遠慮ください。

株式会社 三啓 大阪営業所

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 20-27

T E L：06-6318-7770、<https://www.sankei-coltd.co.jp/companyinfo/office/>